



VIA Technologies, Inc.

531 Zhongzheng Road, 1F | Xindian Dist, New Taipei City 231 | Taiwan
Tel: +886-2-2218-1838 | Fax: +886-2-2218-8924 | www.viatech.com

VIA、Qualcomm® Snapdragon™ 820E エンベデッドプラットフォーム採用の VIA SOM-9X20 エッジ AI 開発キットの Chip One Stop における取り扱いを開始

2018 年 8 月 23 日 台湾・新北市 – VIA Technologies, Inc.は、本日、Qualcomm Incorporated の子会社である Qualcomm Technologies, Inc の Qualcomm® Snapdragon™ 820E エンベデッド・プラットフォームを採用することでインテリジェントなエッジ AI システムおよびデバイスの設計、テストおよび展開を簡素化する VIA SOM-9X20 エッジ AI 開発キットについて、株式会社チップワンストップ(本社:神奈川県横浜市)の運営する電子部品および半導体の通販サイト Chip One Stop(<https://www.chip1stop.com/>)で取り扱いを開始すると発表しました。これにより、これまでの VIA オンラインショップを通じての販売に比べて、よりお手軽に、かつ迅速に VIA SOM-9X20 エッジ AI 開発キットをお手もとにお届けできるようになります。



本キットは、VIA SOM-9X20 SOM モジュールと SOMDB2 キャリアボード、インテリジェントなリアルタイムのビデオキャプチャ、プロセッシングおよびエッジ解析に最適化された 13MP カメラモジュールを組み合わせています。エッジ AI アプリケーションの開発は Snapdragon Neural Processing Engine (NPE) のサポートと、AI アプリケーションを駆動する Qualcomm® Hexagon™ DSP、Qualcomm® Adreno™ 530 GPU、または Qualcomm® Kryo™ CPU のフルアクセラレーションをに対応した Android 8.0 BSP または Yocto 2.0.3 に基づく Linux BSP で可能になります。

VIA、Qualcomm® Snapdragon™ 820E エンベデッドプラットフォーム採用の VIA SOM-9X20 エッジ AI 開発キットの Chip One One Stop における取り扱いを開始

2/3

今回、Chip One Stop システムで取り扱いを開始する VIA SOM-9X20 エッジ AI 開発キットは以下のとおり。

- VIA SOM-9X20 スターターキット : 96,200 円 (税別)
SOM-9X20 モジュール、SOMDB2 キャリアボード
- VIA SOM-9X20 スターターキット (カメラ・ディスプレイ付き) : 98,000 円 (税別)
VIA SOM-9X20 SOM モジュールと SOMDB2 キャリアボードおよび 13MP CMOS カメラモジュール (COB1/3.06" 4224 × 3136 ピクセル)

VIA SOM-9X20

VIA SOM-9X20 は、Qualcomm の Snapdragon 820E エンベデッドプラットフォームを搭載した高度に統合されたシステム・オン・モジュール (SOM) です。本モジュールは、わずか 8.2 × 4.5cm のサイズで、64GB eMMC フラッシュメモリと 4GB LPDDR4 SDRAM を搭載し、MXM 3.0 314 ピンコネクタを介して USB 2.0、HDMI 2.0、SDIO PCIe、MIPI CSI、MIPI DSI、UART 用多機能ピン、I2C、SPI、GPIO などの豊富な I/O とディスプレイ拡張拡張オプションを提供します。その主な特徴は以下のとおりです。

- Qualcomm® Snapdragon™ 820 エンベデッドプラットフォーム
- 4K @ 60fps、8 x 1080p @ 30fps をサポートする Qualcomm® Adreno™ 430 GPU
- 内蔵 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.1 および GPS の豊富な無線接続性
- MXM 3.0 314 ピンコネクタを備えたコンパクトフォームファクタモジュール
- 5 年間の長期サポート

また、VIA は、システムの商用化を加速し、開発コストを最小限に抑えるハードウェアとソフトウェアのカスタマイズサービスを提供するほか、フルターンキー開発サービスも利用いただけます。

なお、VIA SOM-9X20 の詳細については、次の URL を参照してください。

<https://www.viatech.com/ja/boards-ja/modules/som-9x20/>

このリリースに関連する画像については、<https://www.viagallery.com/som-9x20/> をご覧ください。

【Chip One Stop における VIA SOM-9X20 開発キット情報ページ】

<http://sp.chip1stop.com/viasom9x20som/>

VIA Technologies, Inc.について

VIA Technologies, Inc.は、AI、IoT、コンピュータビジョン、自動運転車両、ヘルスケア、スマートシティアプリケーション向けの高度に統合された組み込みプラットフォームおよびシステムソリューションの開発における世界的リーダーです。本社を台湾・台北におき、VIA の国際的なネットワークはアメリカ、ヨーロッパ、そしてアジアのハイテクセンターを結び、顧客層は世界中の最先端のハイテク、通信、家電にまでわたっています。詳しくはこちらをご覧ください。

<http://www.viatech.com/>

**VIA、Qualcomm® Snapdragon™ 820E エンベデッドプラットフォーム採用の
VIA SOM-9X20 エッジ AI 開発キットの Chip One One Stop における取り扱いを開始**

3/3

お客様からのお問い合わせ先

VIA Technologies Japan 株式会社

メールアドレス: mktjp@viatech.co.jp

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

Richard Brown (VIA Technologies, Inc. 国際マーケティング担当 VP)

メールアドレス: RIBrown@via.com.tw

HaNaRe PR Group (VIA Technologies, Inc. 日本広報代理)

メールアドレス: press@hanare-pr.jp

記者ならびに編集の方々へお願い: VIA はすべて大文字で表記してください。

Qualcomm, Snapdragon, Kryo, Adreno, および Hexagon は、米国およびその他の国における Qualcomm Incorporated の商標です。Qualcomm Spectra は、Qualcomm Incorporated の商標です。

Qualcomm Snapdragon, Qualcomm Kryo, Qualcomm Adreno, Qualcomm Hexagon, および Qualcomm Spectra は、Qualcomm Technologies, Inc. の製品です。

ここに記載されている実際の企業および製品名は、それぞれの所有者の商標です。